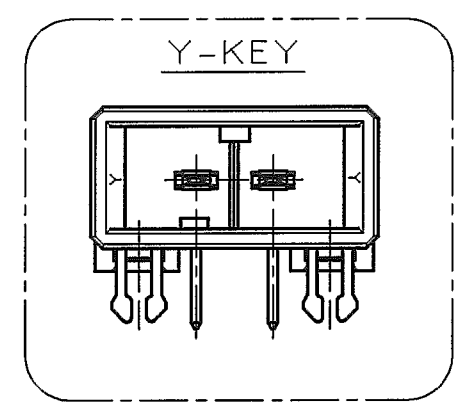
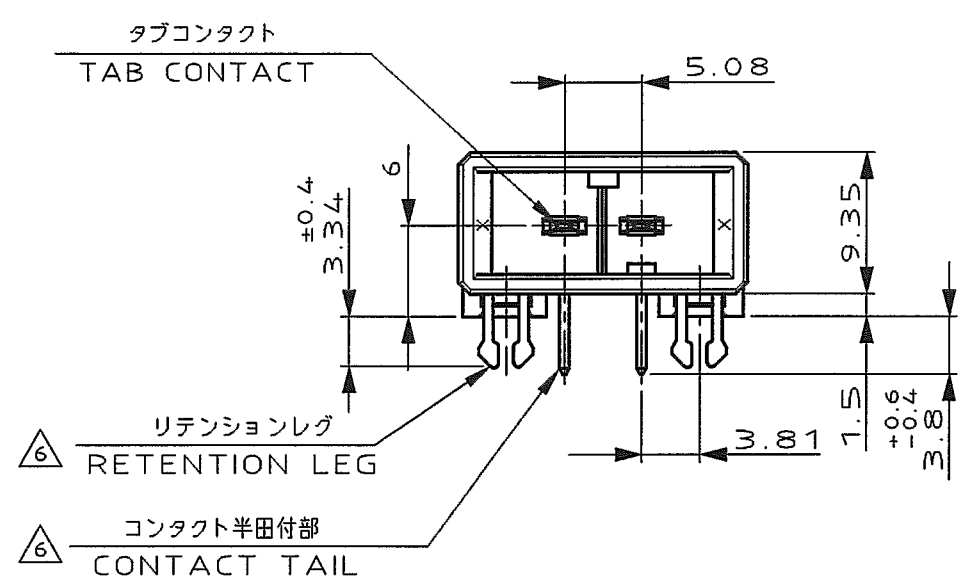
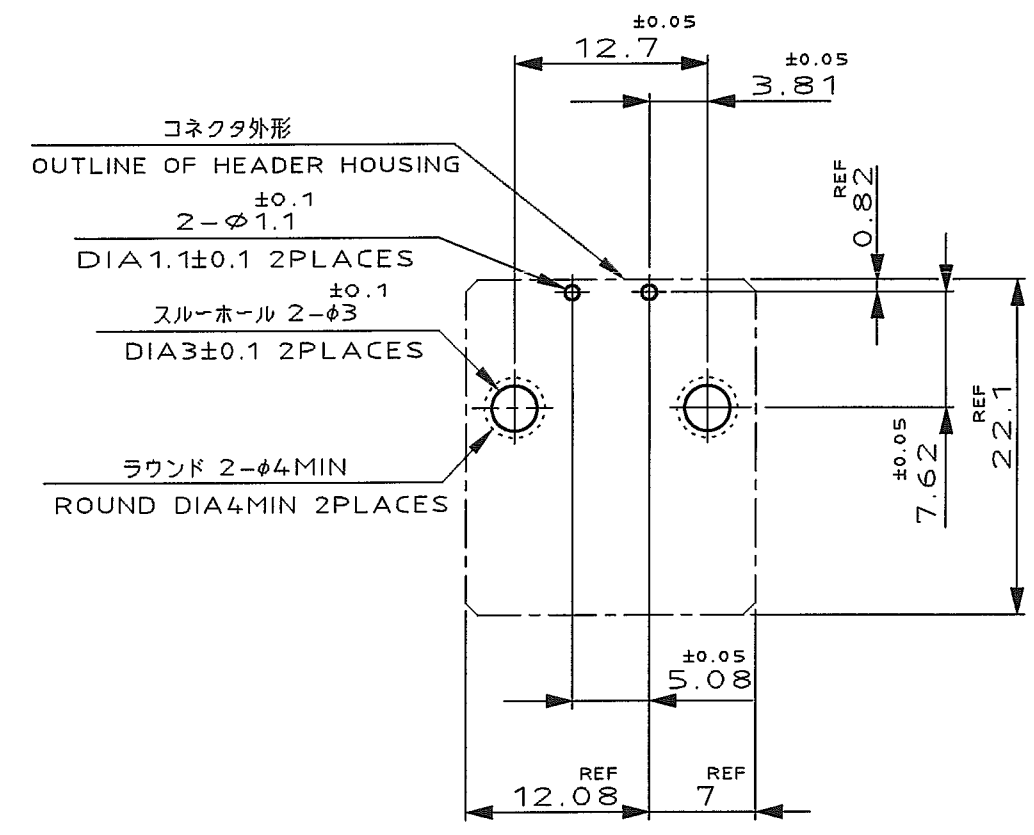
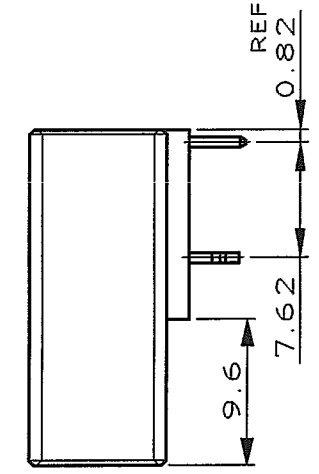
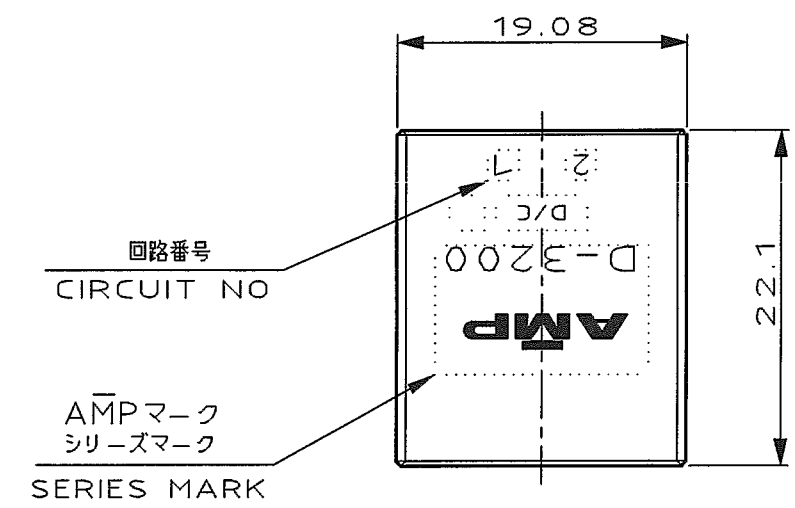


NUMBER 179276
 METRIC
 DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT
 PRINT DIST



推奨基板取付け穴寸法
 PC 基板厚: 1.6±0.1
 (非累積公差)
 (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
 PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
 (CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
7. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
 コネクタ: 銅合金
 リテンションレグ: 銅合金
2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 接触部: 0.38μm MIN金めっき
3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 接触部: 0.76μm MIN金めっき
4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
 ニッケル下地の上に半田めっき
6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
 ニッケル下地の上にスズめっき

OBSOLETE	6	4	2-179276-5	Y
	6	3	2-179276-3	Y
	6	2	2-179276-2	Y
	6	4	1-179276-5	X
	6	3	1-179276-3	X
	6	2	1-179276-2	X
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)	KEY	

B2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	22MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

WIRE RANGE	INSULATION DIA	NAME
mm(AWG -)	mmφ	2 POS SINGLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC D-3200
MATERIAL	FINISH	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
SEE NOTE	SEE NOTE	10MF : ±0.2
注記参照	注記参照	100MF : ±0.3
		300MF : ±0.4
		角 度 : ±3'

TE Connectivity			
SIZE	LOC	NUMBER	
A3	J	C=179276	
SCALE	REV.	SHEET	
2-1	B2	1 OF 1	

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-179276-5](#)